

Title (en)

ARRANGEMENT FOR MOUNTING A LED MODULE ON A SURFACE OF A COOLING BODY AND LED ASSEMBLY

Title (de)

ANORDNUNG ZUR MONTAGE EINES LED-MODULS AUF EINER OBERFLÄCHE EINES KÜHLKÖRPERS SOWIE LED-ANORDNUNG

Title (fr)

ARRANGEMENT D'UN MONTAGE D'UN MODULE LED SUR UNE SURFACE D'UN CORPS DE REFROIDISSEMENT ET MONTAGE LED

Publication

**EP 3064827 A1 20160907 (DE)**

Application

**EP 16158385 A 20160303**

Priority

DE 202015101026 U 20150304

Abstract (de)

Eine Anordnung zur Montage eines LED-Moduls (1) auf einer Oberfläche (21) eines Kühlkörpers (2) weist ein Andruckelement (3) zum Andrücken des LED-Moduls (1) gegen die Oberfläche (21) sowie ein Federelement (4) für eine schwimmende Lagerung des Andruckelements (3) gegenüber der Oberfläche (21) auf.

IPC 8 full level

**F21V 7/06** (2006.01); **F21V 17/12** (2006.01); **F21V 29/70** (2015.01)

CPC (source: EP US)

**F21V 7/06** (2013.01 - EP); **F21V 17/005** (2013.01 - EP); **F21V 17/12** (2013.01 - EP US); **F21V 29/70** (2015.01 - EP);  
**F21Y 2115/10** (2016.07 - EP US)

Citation (search report)

- [XYI] US 7182627 B1 20070227 - HUANG BIN-JUINE [TW]
- [XY] US 2014301089 A1 20141009 - STUCCHI ANTONIETTA [IT]
- [XI] WO 2013174766 A1 20131128 - OSRAM GMBH [DE], et al
- [XI] EP 1780804 A1 20070502 - L & C LIGHTING TECHNOLOGY CORP [TW]
- [X] JP 2006310138 A 20061109 - MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD
- [Y] US 2013056185 A1 20130307 - BAYERER REINHOLD [DE], et al
- [Y] US 2008158887 A1 20080703 - ZHU MING-WU [CN], et al

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

**DE 202015101026 U1 20160607**; EP 3064827 A1 20160907; EP 3064827 B1 20190508

DOCDB simple family (application)

**DE 202015101026 U 20150304**; EP 16158385 A 20160303